



# 中華民國專利證書

發明第 I 825518 號

發明名稱：覆晶封裝結構及其製造方法

專利權人：慧隆科技股份有限公司

發明人：蔡憲聰、施養明、許宏源

專利權期間：自 2023 年 12 月 11 日至 2041 年 12 月 2 日止

上開發明業經專利權人依專利法之規定取得專利權

經濟部智慧財產局 局長

廖承威

中華民國



112

年

12

月

11

日

